

***Judul:***

Analisis Pembuatan Lead Frame Atmega328p Tipe Plastic Dual In-Line Package Dengan 28 Lead Menggunakan Wire-EDM Dan Tin Electroplating Sederhana = Lead frame Manufacturing Analysis of Atmega328p Plastic Dual In-Line Package Type With 28 Leads Using Wire-EDM and Simple Tin Electroplating

***Pengarang/Penulis:***

Asyif Alamsyah, author

***Subjek:***

Integrated circuits--Congresses.

***Nomor Panggil:***

S-pdf

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)